



株式会社 新 川
ニュースリリース

2013 年 10 月 28 日

TCB 工法サブストレート用フリップチップボンダ LFB-1102Super 受注開始

株式会社新川（社長：西村浩、東京都武蔵村山市伊奈平二丁目 51 番地の 1）は、2012 年 10 月に市場投入したフリップチップボンダ「LFB-1102」をコンパクト化した量産対応装置として、「LFB-1102Super」の開発を完了し、受注を開始しました。

同機種は、28nm 以降の先端デバイスの組立工程への適用が進みつつある TCB（*1）工法に対応したサブストレート用（C2S *2）機種です。TCB フリップチップ工法は、狭ピッチ化が進む Cu ピラープロセスへの適用が始まると共に、次世代スマートホン・通信機器の高速化・低消費電力化のキーとなる TSV を用いた 3 次元実装技術で必要とされる技術として注目されています。同機種は、TCB 工法に必要とされる高精度 XYZ 制御機能に加え、高速パルスヒータを用いた短時間加熱・冷却により、高スループットを実現できます。また、2 ヘッドタイプにすることで、省スペースと生産性の向上に寄与します。



【TCB フリップチップボンダ LFB-1102Super】

【LFB-1102Super の特長】

- (1) 幅広い荷重範囲で高精度な高さ制御を可能にしたボンダヘッド
- (2) 低振動制御技術を生かした高精度XYアライメント機能
- (3) 高速パルスヒータを用いた短時間加熱・冷却による高スループット
- (4) 安定した品質とプロセスポータビリティを確保するプロセスモニタリング・管理機能
- (5) 薄ダイピックアップに対応
- (6) オプションによりFlux-TCBプロセスにも対応
- (7) 装置サイズのコンパクト化を実現（従来機種比：床面積15%減）

*1 TCB : Thermal Compression Bonding

*2 C2S : Chip to Substrate

■ その他当社取扱製品

ワイヤボンダ、ダイボンダ、バンプボンダ等

■ お問い合わせ先

お客様お問い合わせ担当：フリップチップ営業部 北林 靖基 ・ 安藤 秀彦 (TEL:042-560-1225)

報道機関お問い合わせ担当：経営企画部 森 琢也 (TEL : 042-560-4848)

以上

株式会社 新 川

〒208-8585 東京都武蔵村山市伊奈平 2-51-1